



MOC8108300

Număr parc	MOC8108300	Statutul RoHs	
Producator / Marca	AMI Semiconductor/onsemi	Starea stocului	4477 pcs stock
Descriere produs	OPTOISOLATOR 5.3KV TRANS 6-DIP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	CNY171-74 , CNY17F1-F4 , MOC8101-08.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de MOC8108300

Tensiune - ieșire (Max)	70V	Tensiune - Izolare	5300Vrms
Tensiune - înainte (Vf) (tip)	1.15V	Saturație Vce (Max)	400mV
Pornirea / oprirea timpului (tip)	2μs, 3μs	Pachetul dispozitivului furnizor	6-DIP
Serie	-	Timp de creștere / înălțime (tip)	1μs, 2μs
Pachet / Caz	6-DIP (0.300", 7.62mm)	Pachet	Tube
Tipul de ieșire	Transistor	Temperatura de Operare	-55°C ~ 100°C
Număr de canale	1	Tipul de montare	Through Hole
Tip de introducere	DC	Rata de transfer curent (Min)	250% @ 10mA
Raportul curent de transfer (Max)	600% @ 10mA	Curent - ieșire / canal	50mA
Curent - DC înainte (dacă) (max)	100 mA	Numărul produsului de bază	MOC810

Vești înrudite



Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un stocare

2023/03/27

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Catapultă cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

2023/03/16

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5